



立景光電推出全球第一個 USB 3.0 的微投影解決方案 讓電腦立刻擁有微投影功能

[台南，2011年1月18日] 奇景光電子公司立景光電今天宣布，推出領先業界、全世界第一個支援 USB 3.0 介面的微投影解決方案。此方案是以立景光電的LCOS微投影的SVGA面板，結合最新的USB 3.0介面的晶片，透過USB 3.0的高速傳輸，利用 PC / NB 提供充電，不需要再外接電源，就可即時 (real-time) 同步支援SVGA的影像播放。這個領先業界其他微投影技術的解決方案，將可使PC/NB立刻升級擁有微投影功能，堪稱微投影市場的夢幻應用。目前已有多家國際級一線筆記型電腦大廠對此表示高度興趣。

立景光電 (Himax Display Inc.) 的USB 3.0合作夥伴，是智原科技 (Faraday Technology Corporation) 百分之百轉投資的原昶科技 (Evolution Technology Corporation) 。這個合作是以立景光電LCOS 微投影 SVGA解析度的面板，結合原昶科技近日推出的USB 3.0 晶片 (ET12U320A) ，所建構而成的解決方案，可以一舉解決USB 2.0頻寬 (480Mbps) 不足的問題，快速提升投影影片播放的功能與流暢度。

電子產品推陳出新，高速傳輸的需求與日俱增。USB 3.0 具有可向下相容、傳輸速度較 USB 2.0 提升 10 倍的明顯優勢，除了可以涵蓋以往 USB 2.0 既有的應用範圍外，也可帶動微投影功能的市場需求。由於 USB 2.0 只能在 VGA (640x480)解析度的面板上使用，會受限於資料傳輸的頻寬不足，使得影像播放畫面延遲不流暢。USB 3.0 則可完全解決 USB 2.0 頻寬不足的問題，可即時傳輸清晰影像，在立景光電的 LCOS 微投影面板中，目前已可支援到 SVGA (800x600)的高品質解析度，未來最高還可支援到 Full HD (1920x1080) 的解析度。

USB目前在全世界業界已被廣泛使用，這將使立景光電的 USB 3.0 LCOS微投影解決方案，具有極大的市場優勢。立景光電副總經理蔡憲彰表示，立景光電USB 3.0 的LCOS微投影解決方案，在微投影市場上有兩大特色，第一個特色是全世界第一家能使用USB 3.0，以微投影方式投射出流暢畫面，與PC / NB同步的高解析度內容；第二則是即時投影功能，馬上播放，不需要內建或外接電源，即可使PC / NB具備微投影功能。對具有微投影需求的使用者而言，大幅提升在使用上的可攜性及便利性。此解決方案，建構高解析度的隨身投影設備，可應用在筆記型電腦、桌上型電腦、監視器、數位相框、相機、手機等多種顯示器上。

針對USB的解決方案，立景光電目前微投影高解析度 SVGA / XGA 面板已進入量產，更高解析度的微投影 WXGA 面板亦已送樣中。相信經由一連串的技术突破與產業合作，隨著 USB 3.0 的日漸普及，很快可以見到隨身式投影產品成為電腦市場的主流。

關於奇景光電

本公司係為一 IC 設計公司並為面板關鍵零組件供應商，主要產品為各尺寸面板之驅動 IC。其產品在大尺寸之應用有桌上型螢幕、筆記型電腦螢幕及電視，在中小尺寸的應用有手機面板及消費性電子產品面板如數位相機、遊戲機以及汽車導航面板。此外，本公司也提供時序控制器、觸控面板 IC、液晶電視及監視器控制 IC、LCOS 微型顯示器、電源管理 IC、LED 驅動 IC、CMOS 影像感測器、iCT 無限色彩技術、2D 轉 3D 解決方案等產品。本公司之總公司位於台灣台南，並於台灣的新竹、台北，大陸的寧波、佛山、福清、北京、上海、蘇州、深圳，日本橫濱、松阪，韓國天安，以及美國加州爾灣皆設有辦公室。

新聞聯絡人:

王巧潔
投資人關係
奇景光電
+886-2-2370-3999 分機 22618
jessie_wang@himax.com.tw

黃華珮
媒體關係
奇景光電
+886-2-2370-3999 分機 22513
jessica_huang@himax.com.tw

In the U.S.
Joseph Villalta
The Ruth Group
+1-646-536-7003
jvillalta@theruthgroup.com

風險說明:

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測與台灣上市計畫，含有風險及不確定性，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動IC產品及非驅動IC產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才、股東對台灣上市的支持度、台灣及美國主管機關政策的改變、台灣證券交易所對於本公司上市的接受度、台灣及美國資本市場的變動、資本市場對於本公司股票發行的接受度、本公司普通股及ADS雙向轉換的狀況以及其他本公司在美國證交所申報的文件中提到的相關風險，包括本公司於2010年6月3日為2009年度所申報修訂的20-F文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。